

● LGA-8B01 パッケージ許容損失

LGA-8B01 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pb フリーはんだ

実装基盤: 銅箔 4 層基板 40mm×40mm (片面 1600mm²)

に対して

1 層目: 約 50%_リード 1/4/5/8 と接続

2 層目: 約 50%_リード 1/4/5/8 と接続

3 層目: 約 50%_リード 1/4/5/8 と接続

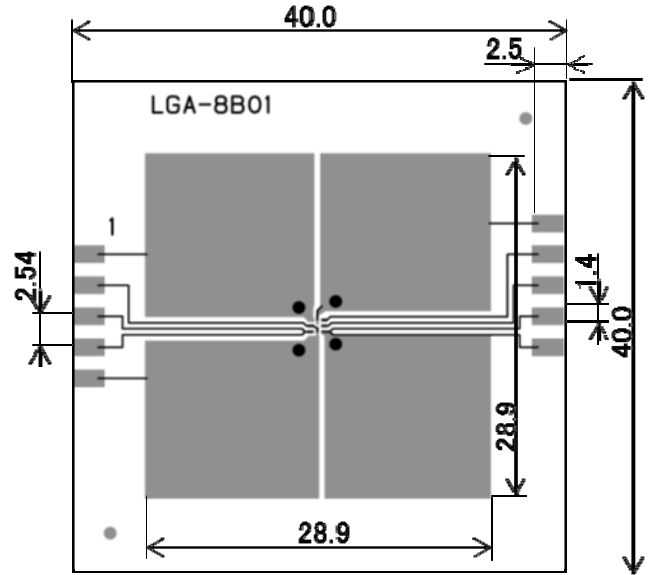
4 層目: 約 50%_リード 1/4/5/8 と接続

(各リード 表面 約 12.5%-裏面 約 12.5%の銅箔と接続)

基板材質: ガラスエポキシ (FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4 個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}C$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	1000	100.00
105	200	

